



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206146572 U

(45)授权公告日 2017.05.03

(21)申请号 201621068031.1

(22)申请日 2016.09.21

(73)专利权人 河南三方元泰检测技术有限公司

地址 450000 河南省郑州市经济技术开发区第一大街与经南三路交叉口凯通产业园2号楼201号

(72)发明人 秦学磊 石林 陈志永 郭海敏

(74)专利代理机构 郑州知己知识产权代理有限公司 41132

代理人 季发军

(51)Int.Cl.

G01L 1/18(2006.01)

G01L 9/06(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

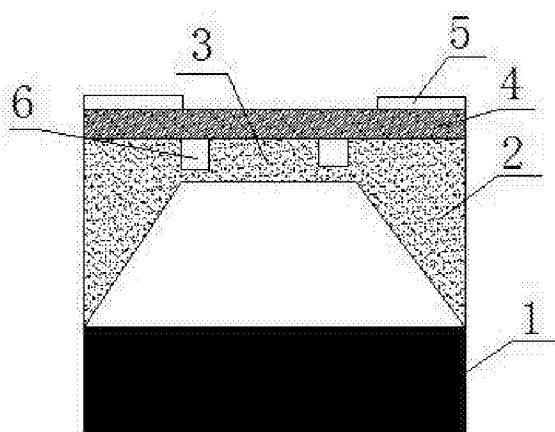
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种高灵敏度集成压力传感器

(57)摘要

本实用新型公开了一种高灵敏度集成压力传感器，其特征在于：包括外壳、芯体和调理电路，所述外壳为密封结构，其内设置有芯体和调理电路；所述芯体包括由至少两个的压力传感器组成的压力传感器阵列；所述压力传感器包括基底、硅衬层、弹性膜片、二氧化硅保护层和金属层；所述硅衬层为E形硅，所述基底为矩形硅，基底和硅衬层为连体结构，基底与硅衬层之间为梯形空腔；所述硅衬层的中间部位设置有弹性膜片，弹性膜片上掺杂形成压敏电阻，压敏电阻上端设有二氧化硅保护层；所述二氧化硅保护层上表面两端分别设置有金属层。本实用新型提供的压力传感器对现有压力传感器的结构进行优化，具有很高的集成度和良好的线性度，灵敏度高。



1. 一种高灵敏度集成压力传感器，其特征在于：包括外壳、芯体和调理电路，所述外壳为密封结构，其内设置有芯体和调理电路；所述芯体包括由至少两个的压力传感器组成的压力传感器阵列；所述压力传感器包括基底、硅衬层、弹性膜片、二氧化硅保护层和金属层；所述硅衬层为E形硅，所述基底为矩形硅，基底和硅衬层为连体结构，基底与硅衬层之间为梯形空腔；所述硅衬层的中间部位设置有弹性膜片，弹性膜片上掺杂形成压敏电阻，压敏电阻上端设有二氧化硅保护层；所述二氧化硅保护层上表面两端分别设置有金属层。

2. 如权利要求1所述的高灵敏度集成压力传感器，其特征在于：所述弹性膜片为中间回形岛结构，膜片四个边上分别连接有压敏电阻，所述压敏电阻为U形压敏电阻。

3. 如权利要求2所述的高灵敏度集成压力传感器，其特征在于：所述弹性膜片的边长为2000um，所述压敏电阻的长度为150um，压敏电阻的宽度为20um。

4. 如权利要求1所述的高灵敏度集成压力传感器，其特征在于：所述压力传感器阵列为Y形三通结构，两个传感器同方向固定在一个传感器的引压接口上。

5. 如权利要求1所述的高灵敏度集成压力传感器，其特征在于：所述调理电路固定在传感器的侧面。

6. 如权利要求1所述的高灵敏度集成压力传感器，其特征在于：所述调理电路包括三端可调正稳压器集成电路LM117、仪表放大器AD620和外围电路；所述AD620连接传感器电桥，并通过电容与LM117连接；所述LM117为传感器和AD620提供电源。

一种高灵敏度集成压力传感器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种压力传感器,特别是一种高灵敏度集成压力传感器。

背景技术

[0002] 压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。目前的压力传感器的灵敏度普遍偏低、线性度较差。改善传感器的方法除了采用高应变系数材料作为敏感元件外,还可以对敏感元件的结构尺寸、电阻的位置和尺寸进行优化。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的发明目的在于:针对上述存在的问题,提供一种采用E形硅衬层,使用中间回形岛结构的弹性膜片,且采用U形压敏电阻,对压力传感器进行优化,同时设有调理电路的具有良好线性度的集成压力传感器。

[0004] 本实用新型采用的技术方案如下:本实用新型一种高灵敏度集成压力传感器,包括外壳、芯体和调理电路,所述外壳为密封结构,其内设置有芯体和调理电路;所述芯体包括由至少两个的压力传感器组成的压力传感器阵列;所述压力传感器包括基底、硅衬层、弹性膜片、二氧化硅保护层和金属层;所述硅衬层为E形硅,所述基底为矩形硅,基底和硅衬层为连体结构,基底与硅衬层之间为梯形空腔;所述硅衬层的中间部位设置有弹性膜片,弹性膜片上掺杂形成压敏电阻,压敏电阻上端设有二氧化硅保护层;所述二氧化硅保护层上表面两端分别设置有金属层。

[0005] 本实用新型一种高灵敏度集成压力传感器,所述弹性膜片为中间回形岛结构,膜片四个边上分别连接有压敏电阻,所述压敏电阻为U形压敏电阻。

[0006] 以上结构中,U形压敏电阻是基于长条形电阻不改变阻值的情况下缩短电阻的长度,使电阻处在应力集中的区域,获得较高的灵敏度,为了减小拐弯处的负压阻效应,在拐弯处注入浓硼重掺杂以降低压阻系数。中间回形岛结构的弹性膜片受力分布集中,同时减小中心扰度,具有很好的线性度。

[0007] 本实用新型一种高灵敏度集成压力传感器,所述弹性膜片的边长为2000um,所述压敏电阻的长度为150um,压敏电阻的宽度为20um。

[0008] 本实用新型一种高灵敏度集成压力传感器,所述压力传感器阵列为Y形三通结构,两个传感器同方向固定在一个传感器的引压接口上。

[0009] 以上Y形三通结构将两个传感器同方向固定在一个传感器的引压接口上,节约了空间,使得多个压力传感器可以集成在芯体上。

[0010] 本实用新型一种高灵敏度集成压力传感器,所述压力传感器的制作方法为:在硅晶圆背面各向异性刻蚀形成空腔,刻蚀后的硅晶圆为硅衬层;在硅衬层的中部掺杂形成压敏电阻;在硅衬层的正面上沉积二氧化硅保护层;在二氧化硅保护层的两端分别溅射金属

层后经剥离形成金属互连线;将硅衬层与基底硅进行键合封装。

[0011] 压力传感器中常用的是硅和玻璃的键合,由于硅和玻璃材料的膨胀系数不同,在键合过程中不可避免地会产生残余应力,而压力传感器对于残余应力十分敏感,采用硅—硅的键合形成全硅结构,能够解决残余应力的问题,提高传感器的性能指标。

[0012] 本实用新型一种高灵敏度集成压力传感器,所述调理电路固定在传感器的侧面。

[0013] 以上结构将调理电路固定在传感器的侧面,而不是像其它压力传感器调理电路板设置在敏感芯体的正上方,固定在侧面可以减小单个传感器的高度,为通信电路板让出安装空间。

[0014] 本实用新型一种高灵敏度集成压力传感器,所述调理电路包括三端可调正稳压器集成电路LM117、仪表放大器AD620和外围电路;所述AD620连接传感器电桥,并通过电容与LM117连接;所述LM117为传感器和AD620提供电源。

[0015] 以上调理电路,具有响应速度快,工作电压宽、功耗低,工作可靠,生产调试方便等优点。

[0016] 综上所述,由于采用了上述技术方案,本实用新型的有益效果是:

[0017] 1、压力传感器的集成度高,Y形三通结构将两个传感器同方向固定在一个传感器的引压接口上,节约了空间,集成多个传感器;调理电路固定在传感器的侧面,可以减小单个传感器的高度,为通信电路板让出安装空间。

[0018] 2、压力传感器的灵敏度高,U形压敏电阻是基于长条形电阻不改变阻值的情况下缩短电阻的长度,使电阻处在应力集中的区域,获得较高的灵敏度;中间回形岛结构的弹性膜片受力分布集中,同时减小中心扰度,具有很好的线性度。

附图说明

[0019] 图1是本实用新型中传感器的结构示意图。

[0020] 图中标记:1为基底,2为硅衬层,3为弹性膜片,4为二氧化硅保护层,5为金属层,6为压敏电阻。

[0021] 图2是弹性膜片的结构示意图。

具体实施方式

[0022] 下面结合附图,对本实用新型作详细的说明。

[0023] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0024] 如图1所示,本实用新型一种高灵敏度集成压力传感器,包括外壳、芯体和调理电路,所述外壳为密封结构,其内设置有芯体和调理电路;所述芯体包括由至少两个的压力传感器组成的压力传感器阵列;所述压力传感器包括基底、硅衬层、弹性膜片、二氧化硅保护层和金属层;所述硅衬层为E形硅,所述基底为矩形硅,基底和硅衬层为连体结构,基底与硅衬层之间为梯形空腔;所述硅衬层的中间部位设置有弹性膜片,弹性膜片上掺杂形成压敏电阻,压敏电阻上端设有二氧化硅保护层;所述二氧化硅保护层上表面两端分别设置有金属层。

[0025] 如图2所示,本实用新型一种高灵敏度集成压力传感器,所述弹性膜片为中间回形岛结构,膜片四个边上分别连接有压敏电阻,所述压敏电阻为U形压敏电阻。

[0026] 本实用新型一种高灵敏度集成压力传感器,所述弹性膜片的边长为2000um,所述压敏电阻的长度为150um,压敏电阻的宽度为20um。

[0027] 本实用新型一种高灵敏度集成压力传感器,所述压力传感器阵列为Y形三通结构,两个传感器同方向固定在一个传感器的引压接口上。

[0028] 本实用新型一种高灵敏度集成压力传感器,所述压力传感器的制作方法为:在硅晶圆背面各向异性刻蚀形成空腔,刻蚀后的硅晶圆为硅衬层;在硅衬层的中部掺杂形成压敏电阻;在硅衬层的正面上沉积二氧化硅保护层;在二氧化硅保护层的两端分别溅射金属层后经剥离形成金属互连线;将硅衬层与基底硅进行键合封装。

[0029] 本实用新型一种高灵敏度集成压力传感器,所述调理电路固定在传感器的侧面。

[0030] 本实用新型一种高灵敏度集成压力传感器,所述调理电路包括三端可调正稳压器集成电路LM117、仪表放大器AD620和外围电路;所述AD620连接传感器电桥,并通过电容与LM117连接;所述LM117为传感器和AD620提供电源。

[0031] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

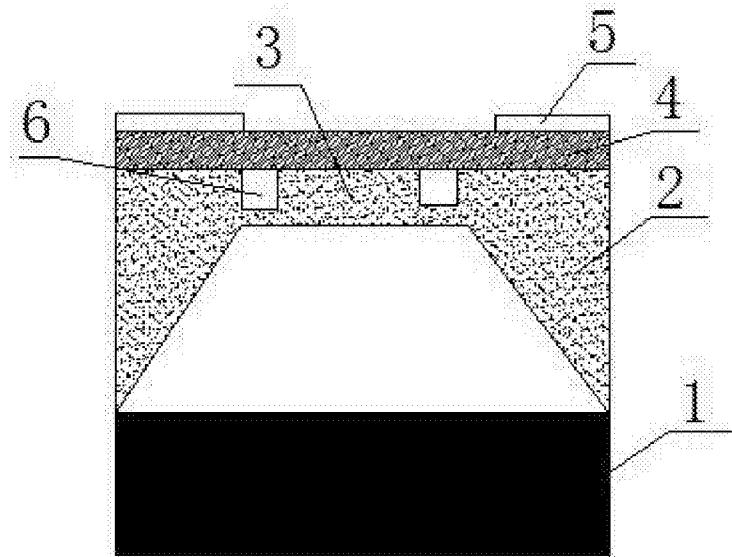


图1

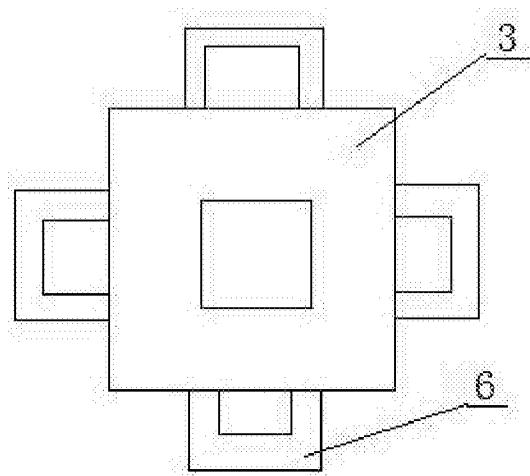


图2